

15.07.2011

## Weiteres Plus für CONTAG-Kunden: OSP im Haus

Mit der Freigabe der Oberfläche OSP hat der Expresslieferant CONTAG ein weiteres Projekt in Richtung Komplett-Dienstleister abgeschlossen. Ab sofort wird auch diese Oberfläche in der Fertigungsstätte in Berlin prozessiert.

OSP (Organic Surface Protection) ist eine dünne und transparente, organische Beschichtung auf der Kupferoberfläche. Die Beschichtung bildet sich durch eine chemische Reaktion des aktiven Bestandteils (substituiertes Imidazolderivat) mit Kupfer. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und hohen Kompatibilität ist es optimal für den Einsatz bei Leiterplatten mit SMD-Technik geeignet und bietet sich damit als alternative Oberfläche an.

### Vorteile von OSP:

- Sehr hohe Hitzebeständigkeit
- Perfekte Kompatibilität mit "Non-Clean Soldering Fluxern" und Lötpasten
- Exzellente Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit von mehr als 6 Monaten
- Nicht-klebrige und einheitliche Beschichtung
- Rückstandsfreie Endoberfläche auf der Leiterplatte
- Chemisch und thermisch ein sehr moderater Prozess
- Geeignet für bleifreies Lötverfahren (Glicoat SMD)

#### Fazit:

CONTAG etabliert sich mit dieser Investition weiter auf dem Markt der PCB-Expressdienstleister an vorderster Stelle und bleibt der Philosophie treu, alle möglichen Technologien im Eildienst inhouse anzubieten.

## Kontakt:

CONTAG GmbH Gesellschafter, Geschäftsführer Herr Andreas Contag Päwesiner Weg 30 13581 Berlin - Germany Telefon: +49 (0) 30-351 788-220

Email: contag@contag.de

CONTAG fertigt Leiterplatten-Prototypen in konkurrenzloser Schnelligkeit und hoher Qualität auch in den verschiedensten Sonderausführungen. Seit 30 Jahren ist das Unternehmen ein in der Elektronikindustrie anerkannter Partner. Am Hauptsitz in Berlin wurde 2010 mit 75 Mitarbeitern ein Umsatz von 9 Mio. € erwirtschaftet.

# Expressfertigung von:

- Ein-, zweiseitige Leiterplatten
- Multilayer bis 24 Lagen
- HDI, Blind- und Buried Via-Technik, Hole Plugging
- Hybrid-Multilayer (z.B. Rogers + FR4)
- Flexible und starr-flexible Leiterplatten
- Impedanzkontrollierte Schaltungen
- Leiterplatten für HF-Anwendungen
- Oberflächen: HAL, chem. Zinn, chem. Ni/Au uvm.
- Sondermaterialien
- Mechanische Sonderausführungen, UL-Zertifizierung